

低功耗 3.0kV rms 双向 I²C 隔离器

产品特性

兼容 I²C 隔离双向通信

超低功耗

最高支持 2MHz 通讯速率

开漏输出

1 侧输出灌电流为3.5mA

2 侧输出灌电流为35mA

3.0V 至 5.5V 供电电压

高共模瞬变抗扰度: 120 kV/μs (典型值)

3000Vrms 测试 1 分钟, 符合 UL 1577

CSA 元件验收通知 5A

DIN VDE V 0884-11:2017-01

V_{ORM} = 565V peak

CQC 认证, 符合 GB4943.1-2011

宽工作温度范围: -40°C ~ 125°C

符合 RoHS 标准的 NB SOIC-8 封装

应用

隔离 I²C, SMBus, PMBus 接口

电动及混合动力汽车

开漏输出网络

I²C 电平转换

二次电源

功能框图

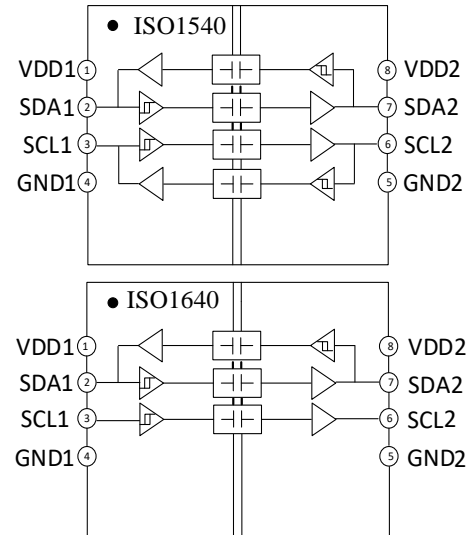


图 1. ISO1540/1640 功能结构框图

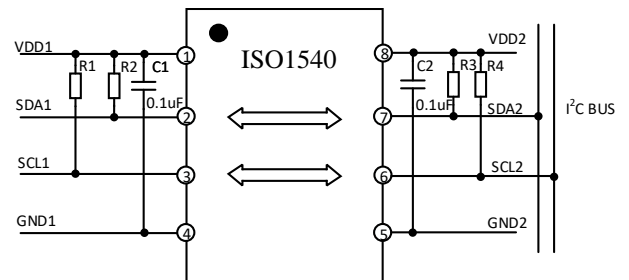


图 2. ISO1540 典型应用电路

引脚配置和功能描述

ISO1540/1640 引脚功能描述

引脚编号	引脚名称	描述
1	VDD1	隔离器 1 侧电源电压。
2	SDA1	1 侧数据输入/输出。
3	SCL1	1 侧时钟输入/输出。
4	GND1	1 侧的参考地。
5	GND2	2 侧的参考地。
6	SCL2	2 侧时钟输入/输出。
7	SDA2	2 侧数据输入/输出。
8	VDD2	隔离器 2 侧电源电压。

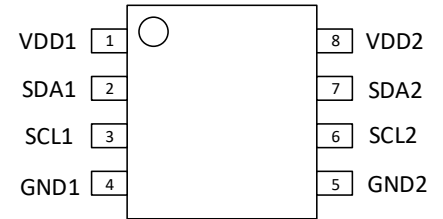


图 3. ISO1540/1640 引脚配置

绝对最大额定值

表 1. 绝对最大额定值^{1,2}

参数	额定值
电源电压 ($V_{DD1-GND1}$, $V_{DD2-GND2}$)	-0.5 V to +7.0 V
输入/输出信号电压 SDA1/SCL1	-0.5 V to $V_{DDx} + 0.5$ V
输入/输出信号电压 SDA2/SCL2	-0.5 V to $V_{DDx} + 0.5$ V
平均输出电流 SDA1/SCL1 (I_{O1})	-20 mA to +20 mA
平均输出电流 SDA2/SCL2 (I_{O2})	-100 mA to +100 mA
存储温度范围 (T_{ST})	-55°C to +150°C
最大结温 $T_{J(MAX)}$	+150°C

注释:

¹所有电压值均为参考同侧 GND ($GND1$ or $GND2$) 引脚测试值, 且均为峰值电压大小。

²绝对最大额定值列出的应力或更高的应力可能会对器件造成永久性损坏, 这些参数仅为绝对最大额定值, 不代表器件在本表所述条件或以上任何其他条件下的正常工作。长时间在超过最大工作条件下工作, 可能会影响产品的可靠性。

建议工作条件

表 2. 建议工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{DDx} ¹	3		5.5	V
输入/输出信号电压 (V_{SDA1} , V_{SCL1} , V_{SDA2} , V_{SCL2})		0		V_{DDx} ¹	V
1 侧逻辑低电平输入电压	VIL1	0		0.47	V
1 侧逻辑高电平输入电压	VIH1	$0.7 \cdot V_{DD1}$		V_{DD1}	V
2 侧逻辑低电平输入电压	VIL2	0		$0.3 \cdot V_{DD2}$	V
2 侧逻辑高电平输入电压	VIH2	$0.7 \cdot V_{DD2}$		V_{DD2}	V
1 侧输出电流	I_{OL1}	0.5		3.5	mA
2 侧输出电流	I_{OL2}	0.5		35	mA
1 侧负载电容	C1			40	pF
2 侧负载电容	C2			400	pF
工作频率	f_{MAX}			2	MHz
工作环境温度	T_A	-40		125	°C

注释:

¹ V_{DDx} 是隔离器电源电压 V_{DD} , 其中 $x = 1$ or 2 。

真值表

表 3. ISO1540/1640 真值表

V _{ix} 输入 ¹	V _{DDi} 状态 ¹	V _{DDo} 状态 ¹	V _{Ox} 输出 ¹
低	上电 ²	上电 ²	低
高	上电 ²	上电 ²	高阻态
悬空 ⁴	上电 ²	上电 ²	高阻态
任意状态	未上电 ³	上电 ²	高阻态
任意状态	上电 ²	未上电 ³	高阻态

注释:

¹ V_{ix}/V_{Ox} 是输入/输出信号电压(SDA 或 SCL); V_{DDi}/V_{DDo} 是输入/输出电源电压。

² 上电是 V_{DDx} ≥ 2.95 V。

³ 未上电是 V_{DDx} < 2.30V。

⁴ 输入条件无效时, I²C 系统的数据和时钟信号通过上拉电阻连接到电源 V_{DD}。

技术规格

电气特性

表 4. 直流特性

 测试条件: V_{DD1} - V_{GND1} = V_{DD2} - V_{GND2} = 3.3V_{DC} ± 10% or 5V_{DC} ± 10%, T_A = 25°C, 除非另有说明。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件/结论
1 侧逻辑电平						
逻辑低电平输入电压 (SDA1 and SCL1)	V _{ILT1}	470	510	570	mV	
逻辑高电平输入电压 (SDA1 and SCL1)	V _{IHT1}	540	580	630	mV	
逻辑输入迟滞电压	V _{HYST1}	50	70		mV	V _{IHT1} - V _{ILT1}
逻辑低电平输出电压 (SDA1 and SCL1)	V _{OL1}	650	720	800	mV	0.5 mA ≤ (I _{SDA1} and I _{SCL1}) ≤ 3.5 mA
逻辑低电平输出电压与逻辑高电平输入电压的差值 (SDA1 and SCL1)	ΔV _{OIT1} ¹	60	120		mV	0.5 mA ≤ (I _{SDA1} and I _{SCL1}) ≤ 3.5 mA
2 侧逻辑电平						
逻辑低电平输入电压 (SDA2 and SCL2)	V _{ILT2}	0.30 * V _{DD2}		0.42 * V _{DD2}	V	
逻辑高电平输入电压 (SDA2 and SCL2)	V _{IHT2}	0.58 * V _{DD2}		0.69 * V _{DD2}	V	
逻辑输入迟滞电压	V _{HYST2}	0.20 * V _{DD2}	0.28 * V _{DD2}		V	V _{IHT2} - V _{ILT2}
逻辑低电平输出电压 (SDA2 and SCL2)	V _{OL2}			0.4	V	0.5 mA ≤ (I _{SDA2} and I _{SCL2}) ≤ 35 mA
双侧参数						
输入漏电流 (SDA1, SCL1, SDA2 and SCL2)	I _{IN}	0.01		10	μA	V _{SDA1} , V _{SCL1} = V _{DD1} ; V _{SDA2} , V _{SCL2} = V _{DD2}
欠压闭锁正 V _{DDx} ² 阈值	V _{DDxUV+}	2.45	2.75	2.95	V	
欠压闭锁负 V _{DDx} ² 阈值	V _{DDxUV-}	2.30	2.60	2.80	V	
V _{DDx} ² 迟滞	V _{DDxUVH}	0.15			V	

注释:

¹ ΔV_{OIT1} = V_{OL1} - V_{IHT1}, 1侧逻辑低电平输出电压与逻辑高电平输入电压的阈值差值是隔离器避免输入/输出逻辑发生锁存的最小允许电压差值。

² V_{DDx} 是隔离器电源电压 V_{DD}, 其中 x = 1 or 2。

表 5. 静态供电电流

测试条件: $V_{DD1} - V_{GND1} = V_{DD2} - V_{GND2} = 3.3V_{DC} \pm 10\%$ or $5V_{DC} \pm 10\%$, $T_A = 25^\circ C$, $R1, R2 = \text{Open}$; $C1, C2 = \text{Open}$ (图 17), 除非另有说明, 测试方法参考图 17。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
ISO1540 静态供电电流($V_{DDx}=5V_{DC}$)	$I_{DD1}(Q)$		1.7	2.4	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = GND1$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = GND2$
	$I_{DD2}(Q)$		1.4	2.1	mA	
	$I_{DD1}(Q)$		1.5	2.3	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = V_{DD1}$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = V_{DD2}$
	$I_{DD2}(Q)$		1.2	1.8	mA	
ISO1540 静态供电电流($V_{DDx}=3.3V_{DC}$)	$I_{DD1}(Q)$		1.5	2.3	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = GND1$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = GND2$
	$I_{DD2}(Q)$		1.2	1.8	mA	
	$I_{DD1}(Q)$		1.5	2.3	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = V_{DD1}$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = V_{DD2}$
	$I_{DD2}(Q)$		1.2	1.8	mA	
ISO1640 静态供电电流($V_{DDx}=5V_{DC}$)	$I_{DD1}(Q)$		1.1	1.7	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = GND1$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = GND2$
	$I_{DD2}(Q)$		1.2	1.8	mA	
	$I_{DD1}(Q)$		1.2	1.8	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = V_{DD1}$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = V_{DD2}$
	$I_{DD2}(Q)$		1.2	1.8	mA	
ISO1640 静态供电电流($V_{DDx}=3.3V_{DC}$)	$I_{DD1}(Q)$		1.0	1.5	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = GND1$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = GND2$
	$I_{DD2}(Q)$		1.1	1.7	mA	
	$I_{DD1}(Q)$		1.1	1.7	mA	$V_{SDA1}, V_{SCL1} = V_{DD1}$; $V_{SDA2}, V_{SCL2} = V_{DD2}$
	$I_{DD2}(Q)$		1.1	1.7	mA	

表 6. 交流特性

测试条件: $V_{DD1} - V_{GND1} = V_{DD2} - V_{GND2} = 3.3V_{DC} \pm 10\%$ or $5V_{DC} \pm 10\%$, $T_A = 25^\circ C$, 除非另有说明, 测试方法参考图 17。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件/结论
输出下降时间 SDA1, SCL1	t_{f1}	10	18	30	ns	$0.9 V_{DD1}$ to $0.9 V$; $R1 = 1430 \Omega, C1 = 40 pF$, @ $5V_{DC}$ 供电
		9	16	28	ns	$R1 = 953 \Omega, C1 = 40 pF$; @ $3.3V_{DC}$ 供电
		6	11	18	ns	$0.7 V_{DD1}$ to $0.3 V_{DD1}$; $R1 = 1430 \Omega, C1 = 40$ pF , @ $5V_{DC}$ 供电
		6	10	16	ns	$R1 = 953 \Omega, C1 = 40 pF$; @ $3.3V_{DC}$ 供电
输出下降时间 (SDA2, SCL2)	t_{f2}	22	36	45	ns	$0.9V_{DD2}$ to $0.4V$; $R2 = 143 \Omega, C2 = 400 pF$, @ $5V_{DC}$ 供电
		20	31	42	ns	$R2 = 95.3 \Omega, C2 = 400 pF$; @ $3.3V_{DC}$ 供电
		9	16	26	ns	$0.7 V_{DD2}$ to $0.3 V_{DD2}$; $R2 = 143 \Omega, C2 = 400 pF$, @ $5V_{DC}$ 供电
		8	14	23	ns	$R2 = 95.3 \Omega, C2 = 400 pF$; @ $3.3V_{DC}$ 供电
1侧至2侧上升传播延时	t_{pLH1-2}	45	68	ns	$0.55 V$ to $0.7 \times V_{DD2}$; $R1 = 1430 \Omega, R2 = 143 \Omega$, $C1, C2 = 10 pF$; @ $5V_{DC}$ 供电	
		38	57	ns	$R1 = 953 \Omega, R2 = 95.3 \Omega, C1, C2 = 10 pF$; @ $3.3V_{DC}$ 供电	
1侧至2侧下降传播延时	t_{pHL1-2}	67	100	ns	$0.7 V$ to $0.4 V$; $R1 = 1430 \Omega, R2 = 143 \Omega, C1, C2$ $= 10 pF$; @ $5V_{DC}$ 供电	
		64	96	ns	$R1 = 953 \Omega, R2 = 95.3 \Omega, C1, C2 = 10 pF$; @ $3.3V_{DC}$ 供电	
脉冲宽度失真 $ t_{pHL1-2} - t_{pLH1-2} $	PWD_{1-2}	22	32	ns	$R1 = 1430 \Omega, R2 = 143 \Omega, C1, C2 = 10 pF$; @ $5V_{DC}$ 供电	

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件/结论
2侧至1侧的上升传播延时	tPLH2-1		26	39	ns	R1 = 953 Ω, R2 = 95.3 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 3.3V _{DC} 供电
			44	62	ns	0.4 × V _{DD2} to 0.7 × V _{DD1} ; R1 = 1430 Ω, R2 = 143 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 5V _{DC} 供电
2侧至1侧的下降传播延时	tPHL2-1		42	56	ns	R1 = 953 Ω, R2 = 95.3 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 3.3V _{DC} 供电
			52	78	ns	0.4 × V _{DD2} to 0.9 V; R1 = 1430 Ω, R2 = 143 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 5V _{DC} 供电
脉冲宽度失真 tpHL2-1 – tpLH2-1	PWD2-1		57	86	ns	R1 = 953 Ω, R2 = 95.3 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 3.3V _{DC} 供电
			8	16	ns	R1 = 1430 Ω, R2 = 143 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 5V _{DC} 供电
1侧环路传播延时	tLOOP1		15	30	ns	R1 = 953 Ω, R2 = 95.3 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 3.3V _{DC} 供电
			104	156	ns	0.4 V to 0.3 × V _{DD1} ; R1 = 1430 Ω, R2 = 143 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 5V _{DC} 供电
共模瞬变抗扰度 ²	CMTI		88	132	ns	R1 = 953 Ω, R2 = 95.3 Ω, C1, C2 = 10 pF; @ 3.3V _{DC} 供电
			120		kV/μs	V _{IN} = V _{DDx} ¹ or 0V, V _{CM} = 1000 V.
静电放电 (人体模型 HBM)	ESD		±6		kV	

注释:

¹ V_{DDx} 是隔离器电源电压 V_{DD}, 其中 x = 1 or 2.

² 共模瞬变抗扰度的测试方法参考图 21。

隔离和安全相关特性

表 7. 隔离特性

参数	符号	额定值	单位	测试条件/结论
		ISO1540/1640		
额定电介质隔离电压		3000	V rms	持续 1 分钟
最小外部电气间隙	L (CLR)	4	mm min	测量输入端至输出端, 空气最短距离
最小外部爬电距离	L (CRP)	4	mm min	测量输入端至输出端, 沿壳体最短距离
最小 PCB 板端爬电距离 (PCB 间隙)	L (PCB)	4.5	mm min	测量输入端至输出端, 空气、PCB 焊接层中的最短距离
最小内部间隙		21	μm min	隔离介质隔离距离
漏电阻抗 (相对漏电指数)	CTI	>400	V	DIN IEC 112/VDE 0303 第 1 部分
材料组别		II		材料组别 (DIN VDE 0110, 1/89, 表 1)

封装特性

表 8. 封装特性

参数	符号	额定值	单位	测试条件/结论
		ISO1540/1640		
电阻 (输入到输出) ¹	R _{I-O}	10 ¹¹	Ω	
电容 (输入到输出) ¹	C _{I-O}	1.5	pF	@1MHz
输入电容 ²	C _I	7	pF	@1MHz
IC 结到环境热阻	θ _{JA}	100	°C/W	热电偶位于封装底部正中间

注释:

¹ 设置器件为双端器件, SOIC-8 引脚 1 至引脚 4 短接, 引脚 5 至引脚 8 短接。

² 输入电容是从任意输入数据引脚到地的容值。

表 9. VDE 隔离特性

描述	测试条件/注释	符号	特性	单位
			ISO1540/1640	
DIN VDE 0110 装置分类				
额定电压电压 ≤ 150 V rms			I to IV	
额定电压电压 ≤ 300 V rms			I to III	
额定电压电压 ≤ 400 V rms			I to III	
环境分类			40/105/21	
污染度 (DIN VDE 0110, 表 1)			2	
最大重复峰值隔离电压		V_{IORM}	565	V peak
输入至输出测试电压, 方法 B1	$V_{IORM} \times 1.5 = V_{pd(m)}$, 100% 生产测试, $t_{ini} = t_m = 1 \text{ sec}$, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$	848	V peak
输入至输出测试电压, 方法 A				
跟随环境测试, 子类 1	$V_{IORM} \times 1.3 = V_{pd(m)}$, $t_{ini} = 60 \text{ sec}$, $t_m = 10 \text{ sec}$, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$	735	V peak
跟随环境测试, 子类 2 和子类 3	$V_{IORM} \times 1.2 = V_{pd(m)}$, $t_{ini} = 60 \text{ sec}$, $t_m = 10 \text{ sec}$, 局部放电 < 5 pC	$V_{pd(m)}$	678	V peak
最高允许过压		V_{IOTM}	4200	V peak
基本隔离浪涌电压	基本隔离, 1.2 μs rise time, 50 μs , 50% fall time, $V_{TEST} = 1.3 \times V_{IOSM}$ (验证测试) ¹	V_{IOSM}	3615	V peak
加强隔离浪涌电压	加强隔离, 1.2 μs rise time, 50 μs , 50% fall time	V_{IOSM}		V peak

描述	测试条件/注释	符号	特性	单位
安全限值	出现故障时允许的最大值(见图 3)			
极限结温		T_S	150	$^{\circ}\text{C}$
25 $^{\circ}\text{C}$ 环温下最大损耗		P_S	1.25	W
T_S 下的绝缘电阻	$V_{IO} = 500\text{ V}$	R_S	$>10^9$	Ω

温度特性曲线

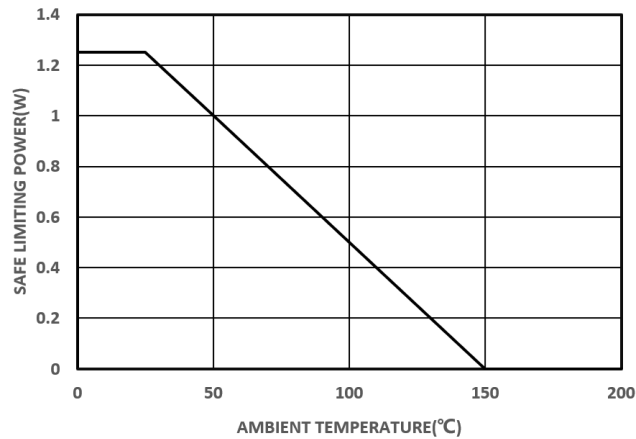


图 4. 热减额曲线, 依据 VDE 获得的安全限值与环境温度的关系

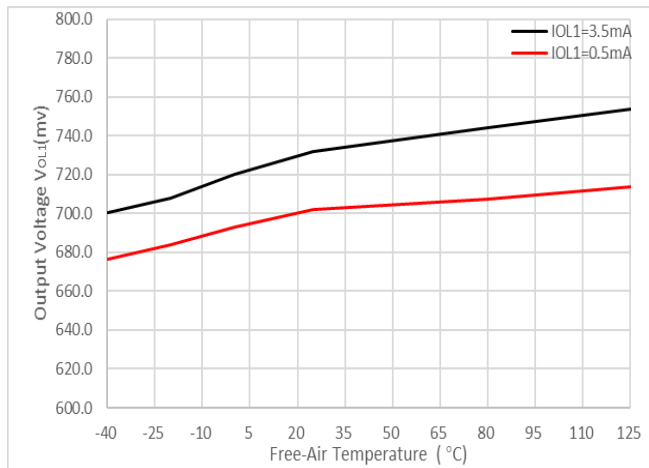


图 5. 1 侧: 输出低电压 vs 环境温度

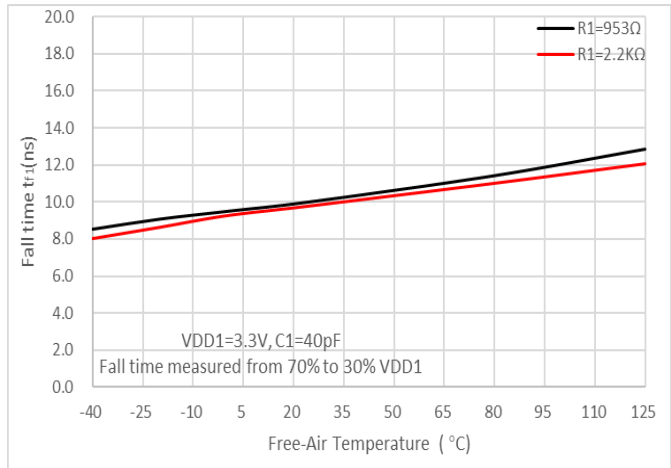


图 6. 1 侧: 输出下降时间 vs 环境温度

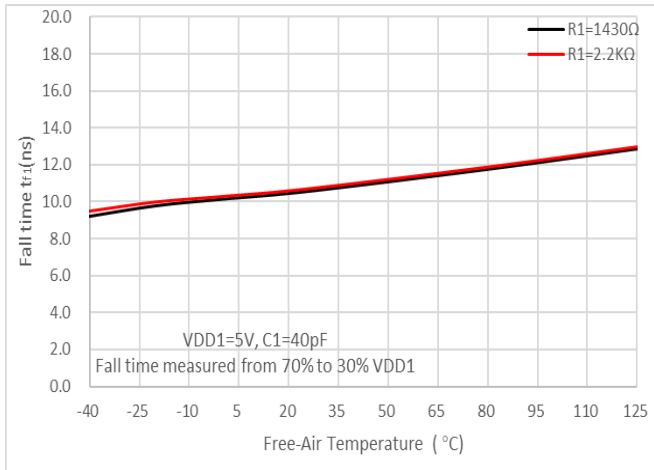


图7. 1侧: 输出下降时间 vs 环境温度

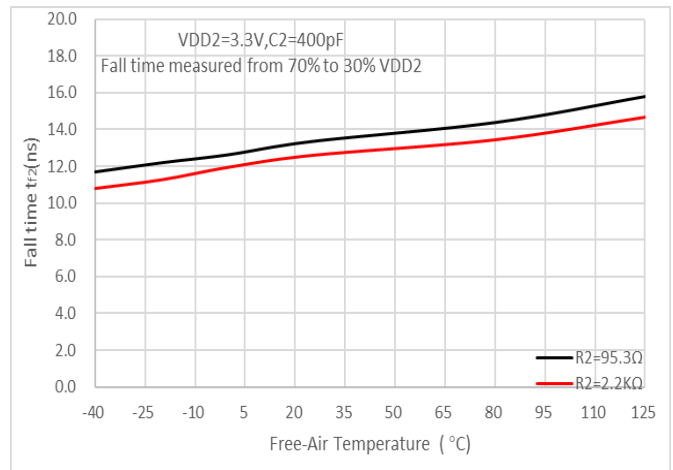


图8. 2侧: 输出下降时间 vs 环境温度

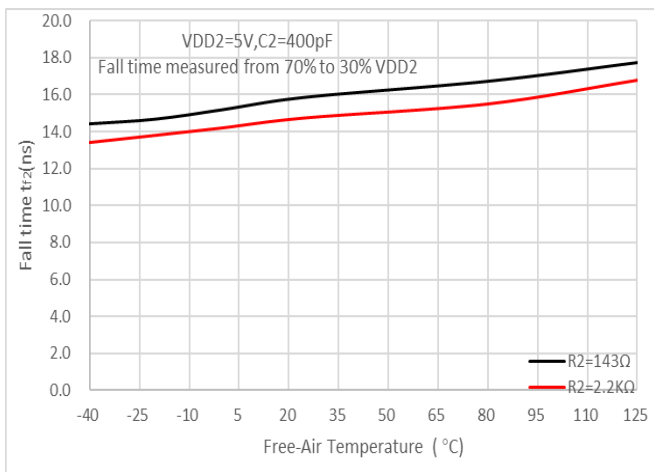
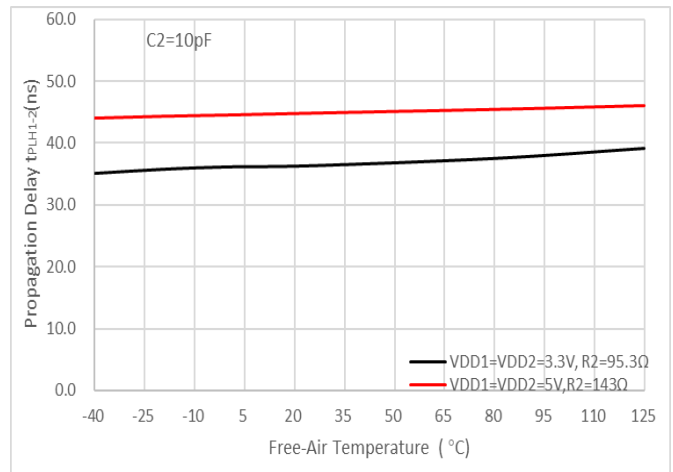
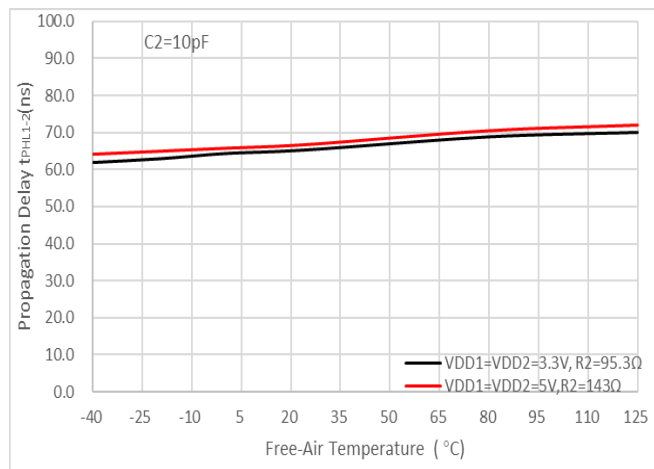
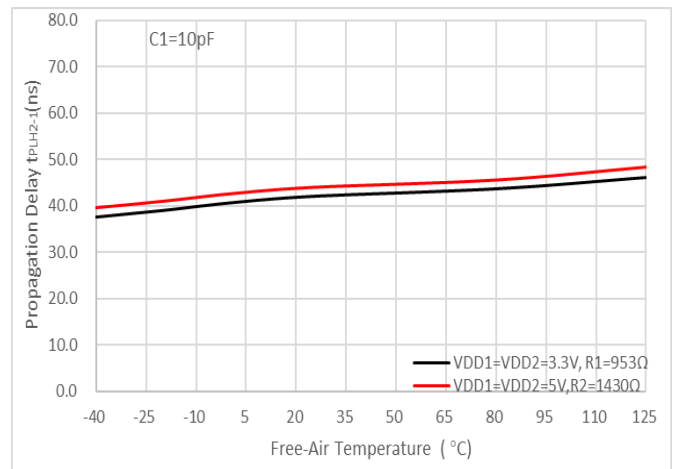


图9. 2侧: 输出下降时间 vs 环境温度


 图10. t_{PLH1-2} 传播延时 vs 环境温度

 图11. t_{PHL1-2} 传播延时 vs 环境温度

 图12. t_{PLH2-1} 传播延时 vs 环境温度

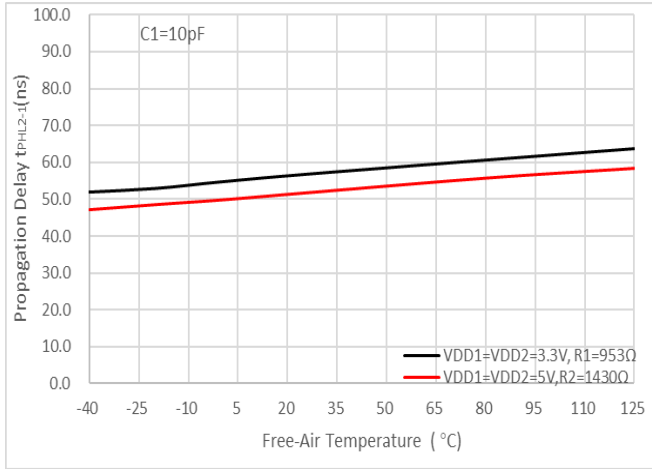


图 13. t_{PHL2-1} 传播延时 vs 环境温度

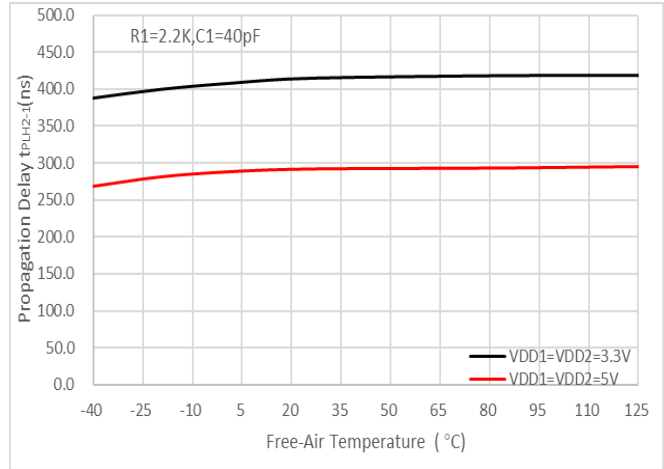


图 14. t_{PLH2-1} 传播延时 vs 环境温度

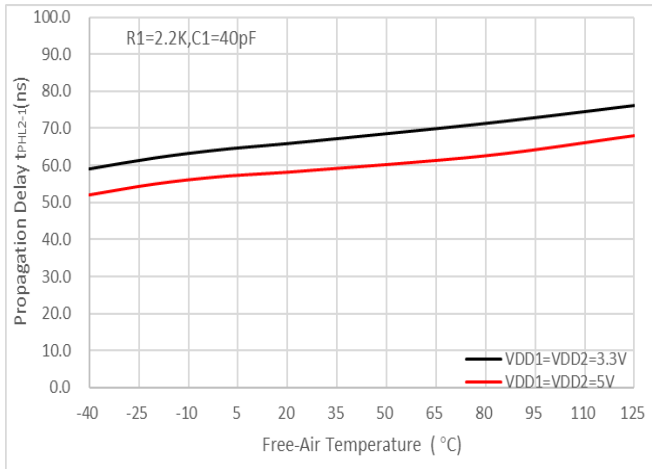


图 15. t_{PHL2-1} 传播延时 vs 环境温度

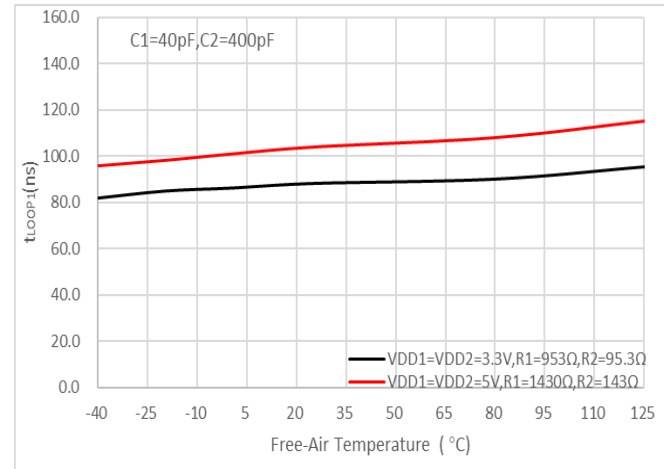


图 16. t_{LOOP1} vs 环境温度

参数测试信息

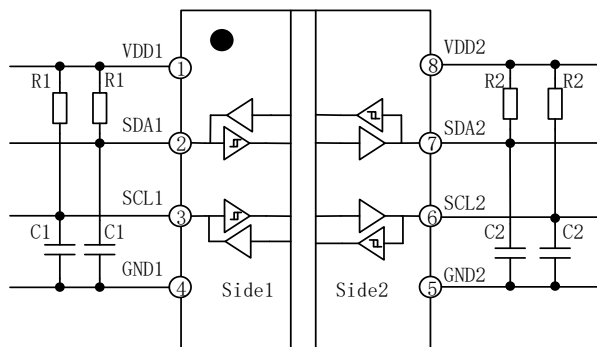


图 17. 测试电路图

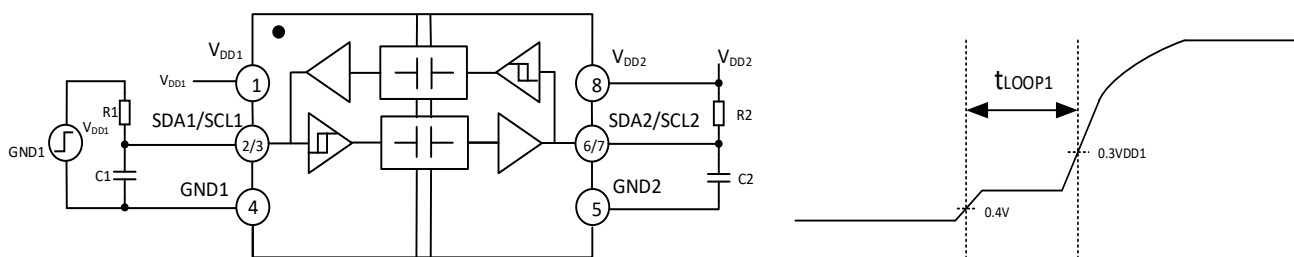
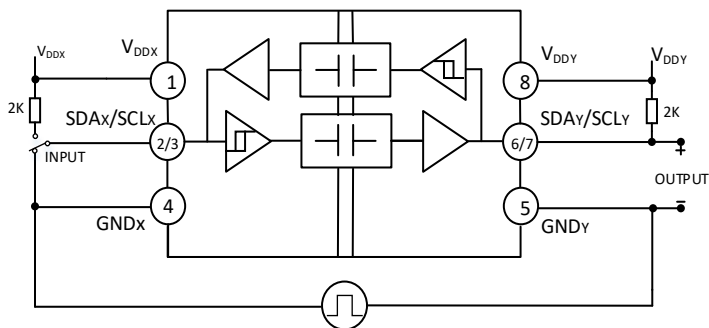

 图 18. t_{loop1} 设置和时序图


图 19. 共模瞬变抗扰度测试电路图

应用信息

概览

I²C 总线是一种双线制串行总线，主要应用于板内或板间通信，应用广泛。I²C 总线可用于多个主设备之间或单个主设备与从设备之间的通信。主设备控制串行时钟线（SCL），数据在主设备和从设备之间的串行数据线上双向传输。I²C 总线理论上可以增加 112 个通信节点，但是节点的数量会增加总线上的负载电容，从而限制通信距离和通信速度。应用中，通常根据实际情况在通信速度、总线长度和节点数量之间进行权衡。I²C 总线支持四种速度的数据传输：标准模式（最高 100Kbps）、快速模式（最高 400Kbps）、快速增强模式（最高 1Mbps）和高速模式（最高 3.4Mbps）。ISO1540/1640 支持上述四种通信模式。

功能描述

ISO1540 和 ISO1640 器件均为兼容 I²C 接口的超低功耗双向隔离器，是基于荣湃半导体的智能分压技术（iDivider®）设计而成。I²C 隔离器的输入和输出采用二氧化硅（SiO₂）介质隔离，可阻断高电压并防止噪声电流进入控制侧接地端，避免电路干扰或损坏敏感电路。

ISO1540 和 ISO1640 各通道均采用符合 I²C 接口的开漏输出技术。串行数据线（SDA）和串行时钟线（SCL）需要增加上拉电阻以保证系统的正常工作。当 I²C 总线上有多个节点时，建议 I²C 隔离器的 1 侧连接到处理器，2 侧连接到总线，因为 2 侧支持高达 400pF 的电容负载。

ISO1540 具有两个双向通道，并且为开漏输出，如图 20 所示。由于一侧的逻辑低导致另一侧的相应管脚被拉低，为了避免设备内的数据锁存，SDA1 和 SCL1 的输出逻辑低（VOL1）电压至少比 SDA1 和 SCL1 的输入高电平阈值（VIHT1）高 60mV，如图 21 所示。

由于 2 侧逻辑电平/阈值是标准 I²C 电平，因此，多个 ISO1540 和 ISO1640 可以通过 2 侧连接到总线上相互通信，并且可以与其他 I²C 兼容设备通信。由于 1 侧引脚是改动后的输出/输入阈值，因此，ISO1540 和 ISO1640 的这一侧只能与符合 I²C 标准的设备通信。

ISO1540 和 ISO1640 能保证 2 侧高达 35mA 和 1 侧高达 3.5mA 输出拉低电流的驱动能力。在进行点对点

通讯时，为了提高系统的可靠性，建议将 I²C 隔离器的 2 侧与导线较长或者负载电容较大的节点连接。

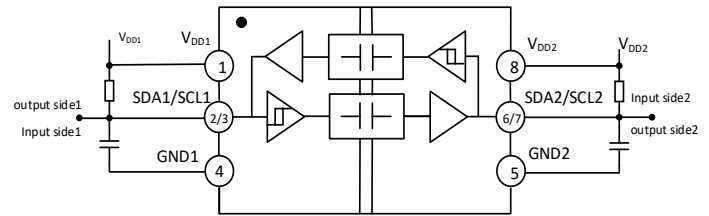


图 20. ISO1540 系统工作图

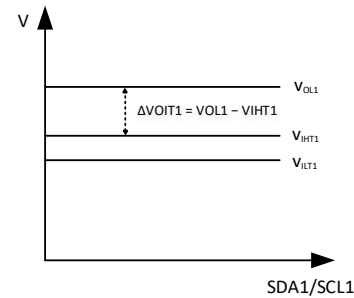


图 21. ISO1540/1640 1 侧输入输出电压关系图

典型应用图

图 22 是一个典型的应用电路，包括 1 侧和 2 侧所需的上拉电阻。VDD1 和 GND1 之间以及 VDD2 和 GND2 之间均需要 0.1μF 到 10μF 的旁路电容。在系统噪声过大的情况下，为了增强系统的鲁棒性，可在 R2 和 C1 之间以及 R3 和 C2 之间串联 50-200Ω 的电阻。

ISO1540 和 ISO1640 的通讯速率高达 2 MHz。由于 1 侧和 2 侧有限的下拉电流能力，在 2 MHz 工作速率下，两侧负载电容分别限制在 40 pF 和 400 pF 以内。

I²C 通讯大多数在 100kbps 标准模式和 400kbps 快速模式下运行。在这些较低的运行速率下，负载电容的限制可以放宽。使用较大的上拉电阻值时，最大负载电容需要按比例减小，以便上升时间不会超过 I²C 标准的要求。

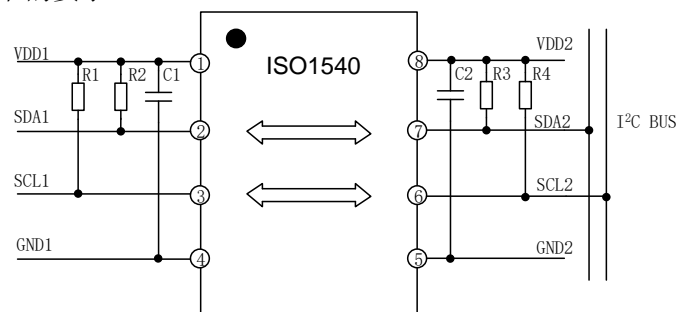
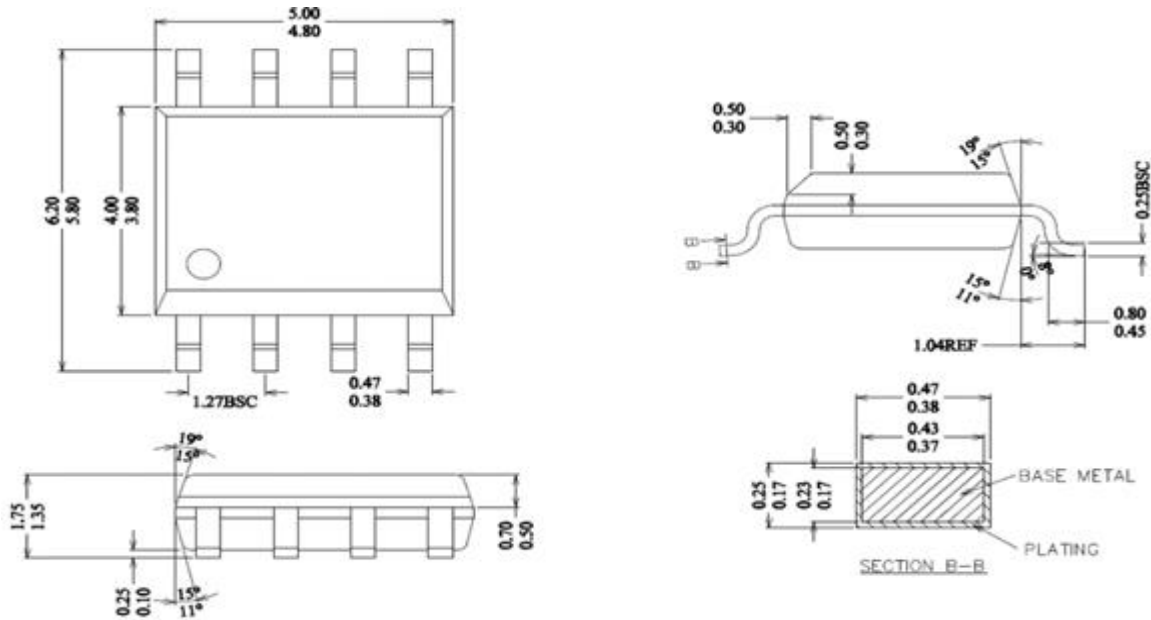


图 22. ISO1540 隔离 I²C 典型电路图

外形尺寸



Notes:

ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MS-012 AA
DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSION.

图 23. NB SOIC-8 封装外形尺寸 - 尺寸单位(mm)

引脚标准

8 引脚窄体 SOIC [NB SOIC-8]

如下图示为 8 引脚窄体 SOIC [NB SOIC-8], 如下表格为引脚尺寸详细信息。

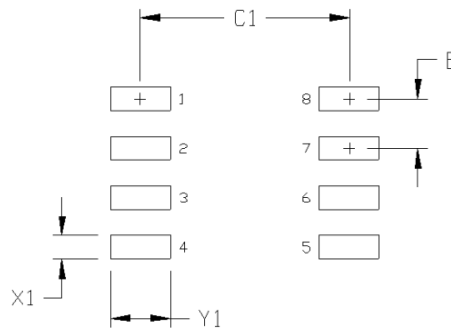


图 24: 8 引脚标准小型封装窄体 SOIC-8

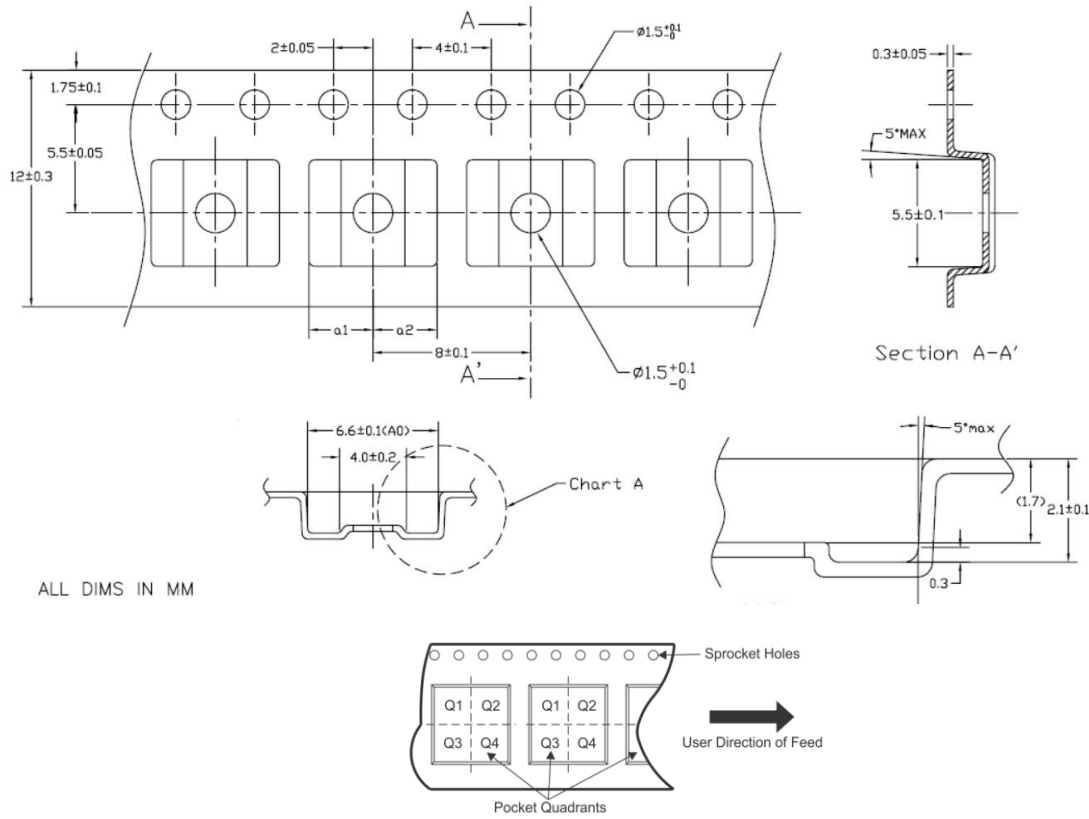
表 11. 8 引脚标准小型封装窄体 SOIC Land 引脚尺寸信息

尺寸	特点	参数	单位
C1	横排焊盘间距	5.40	mm
E	竖排焊盘间距	1.27	mm
X1	焊盘宽度	0.60	mm
Y1	焊盘长度	1.55	mm

注释:

1. 焊盘图形设计依据 IPC -7351。
2. 所有特性尺寸假定为最大材料尺寸和 0.05 毫米的制造公差。

卷带信息



注释：芯片 Pin 1 在 Q1 的象限

图 26：8 引脚窄体 SOIC 封装 [NB SOIC-8] 包装信息尺寸单位(mm)

订购指南

型号		温度范围	输入数, V _{DD1} 侧	输入数, V _{DD2} 侧	耐压范围 (kV rms)	最大数据速 率 (MHZ)	封装描述	MSL Peak Temp	最小订购/ 每卷数
ISO1540	ISO1540DR	-40°C to +125°C	2	2	3	2	NB SOIC-8	Level-2-260C-1 YEAR	4000
ISO1540Q	ISO1540QDR	-40°C to +125°C	2	2	3	2	NB SOIC-8	Level-2-260C-1 YEAR	4000
ISO1640	ISO1640DR	-40°C to +125°C	2	1	3	2	NB SOIC-8	Level-2-260C-1 YEAR	4000
ISO1640Q	ISO1640QDR	-40°C to +125°C	2	1	3	2	NB SOIC-8	Level-2-260C-1 YEAR	4000